

SYNOVA 开放微水刀激光技术授权

微水刀激光科技创始者和专利业者 SYNOVA，发表一项新的策略经营模式，宣布开放严选合作伙伴授权其专利微水刀激光技术（Laser MicroJet Technology）。

在未来，除 SYNOVA 将持续开发、销售及提供其微水刀激光产品服务之外，各领域之设备制造商也能将 SYNOVA 的微水刀激光模块整合至自身的工具设备之中，同时终端使用者亦能将这此模块直接整合到其生产线。

SYNOVA 表示，此项创新授权模式将开创一个全新的策略通路伙伴网络，协助厂商拓展新的营收来源，同时巩固 SYNOVA 技术于全球新市场与应用的地位。该项创举也将能够立刻增加产品产量、服务及销量，使公司能更专注于半导体、平面显示器、太阳能、医学器材及汽车工业等核心产业之客户服务。

在新模式下，SYNOVA 将提供微水刀激光模块的非独家技术授权，包括一个雷射头、雷射光源及水泵，能同时整合至终端使用者与设备制造商的系统中。在终端使用者授权协议的规范下，不必再支付额外的权利金来使用模块。设备制造商也可签订以权利金为基准的前置授权协议，以这种模式来使用模块。

为鼓励长期合作，授权协议亦涵盖技术与知识的转移服务。SYNOVA 的代表将与

授权客户密切合作，确保微水刀激光有效的整合，并协助终端客户维持最佳化的制程灵活度。

SYNOVA 的微水刀激光技术结合激光束与水刀技术，灵活性高、极易调整制程，能配合各种应用的需求。此项技术主要的目标应用包括半导体晶圆切割与边缘研磨、平面显示器中有机发光二极管（OLED）掩模切割、喷墨打印机喷墨头开槽、超硬材料切割（如多晶钻石、立方氮化硼）等众多应用。

除了持续开拓这些核心市场外，SYNOVA 亦积极加入光电、太阳能电池及医疗器械等先进领域。此外，该公司正开放其技术给各个研发机构与大学使用，藉此促进各项应用的发展。

SYNOVA 现正与数家业界领导厂商洽谈，透过这些业者所建立的知名度以及就微水刀激光主要市场所累积的知识，将协助终端使用者实现更多增值服务。SYNOVA 计划在今年陆续发表这些授权合作消息。新经营模式是 SYNOVA 抢进新市场的最新策略，该公司并将于近期启用坐落于美国加州 Fremont、波士顿、日本京都及韩国首尔等地的微加工中心（MMCs），用来展示、测试及开发各种新应用。SYNOVA 目前已在全球客户端设置超过 60 个以上的完全上线运作系统。